



Karta produktowa

MODECOM OBERON PRO

MODECOM



MODECOM OBERON PRO

Obudowa MODECOM OBERON PRO została zaprojektowana dla użytkowników, którzy cenią sobie przestronne i funkcjonalne wnętrze w połączeniu z atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem. Przemyślana konstrukcja wewnętrzna obudowy przeznaczonej dla graczy, w połączeniu z dopracowanymi detalami panelu przedniego, stawiają OBERON PRO na szczególnej pozycji wśród nowych propozycji MODECOM. OBERON PRO spośród innych obudów dla graczy wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym wzornictwem, podkreślonym klasyczną czernią. Wersja OBERON PRO to najnowocześniejsza konstrukcja oparta na doświadczeniach wcześniejszych wersji z serii OBERON. Dopracowane w detalach szczegóły są odpowiedzią na zgłaszane przez użytkowników oczekiwania odnośnie funkcjonalnej obudowy komputerowej.

Kluczowe cechy

- ✓ konstrukcja dla wymagających graczy
- ✓ duże możliwości aranżacyjne wnętrza
- ✓ duża przestrzeń na PSU aż 240 mm
- ✓ gumowe kołnierze otworów przepustowych przewodów
- ✓ wykręcane zaślepki na sloty PCI/PCIe
- ✓ nowoczesne wzornictwo panelu przedniego
- ✓ pięć miejsc na dyski twarde
- ✓ beznarzędziowy montaż kart rozszerzeń
- ✓ dwa wbudowane czarne wentylatory 120 mm
- ✓ filtry zabezpieczające przed kurzem
- ✓ miejsce na karty grafiki aż do 395 mm
- ✓ możliwość montażu chłodzenia procesora do 163 mm





MODECOM OBERON PRO

Obudowa komputerowa

Chłodzenie

Obudowa OBERON PRO posiada fabrycznie zamontowane dwa czarne wentylatory chłodzące o średnicy 120 mm (tył i przód), co przy braku komponentów blokujących przepływ powietrza zapewnia doskonałe chłodzenie wnętrza. Maksymalna wysokość dostępna dla układu chłodzenia procesora to 163 mm.

Organizacja przestrzeni

Obudowa OBERON PRO zapewnia beznarzędziowy montaż kart rozszerzeń, a wygodny system organizacji okablowania pozwala utrzymać uporządkowaną przestrzeń we wnętrzu obudowy. Miejsce do montażu karty graficznej to aż 395 mm.



Funkcjonalne, nowoczesne wnętrze

Obudowa OBERON PRO pozwala użytkownikowi na dowolną aranżację wnętrza według indywidualnych preferencji z wykorzystaniem najnowocześniejszych komponentów, przy jednoczesnym zachowaniu świetnego ich chłodzenia. O czystość wnętrza obudowy dbają łatwo demontowalne filtry: magnetyczny na górze obudowy, w dolnej części panelu przedniego oraz na spodzie, pod zasilaczem.

Miejsca na dyski SSD/HDD

W obudowie można zamontować pięć dysków twardych w konfiguracjach: trzy dyski SSD 2.5" oraz dwa dyski HDD 3.5" (w systemie beznarzędziowym) lub pięć dysków SSD 2.5". Zasilacz oraz miejsce na dyski twarde 3,5"/2,5" umieszczone są w osłonie (tunelu) na spodzie obudowy, natomiast pozostałe miejsce na dyski SSD znajduje się na tylnej stronie szkieletu obudowy.

MODECOM OBERON PRO

Obudowa komputerowa



Praktyczne rozwiązania

W obudowie zastosowano gumowe kołnierze otworów przepustowych przewodów. Gumowy pierścień uszczelniający ma za zadanie zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem.



Wykręcane zaślepki

Wszystkie zaślepki na karty rozszerzeń PCI/PCIe są wykręcane. Pozwala to na ponowną aranżację komponentów i przywrócić obudowę do pierwotnego wyglądu.

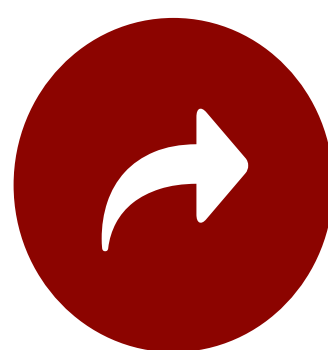
Instalacja długich zasilaczy

We wnętrzu wygospodarowano dużą przestrzeń (240 mm) na zasilacz. Pozwala to na montaż długich zasilaczy oraz łatwą aranżację okablowania. Teraz instalacja zasilacza bez modularnego okablowania jest jeszcze łatwiejsza.



Informacje dodatkowe

MODECOM OBERON PRO



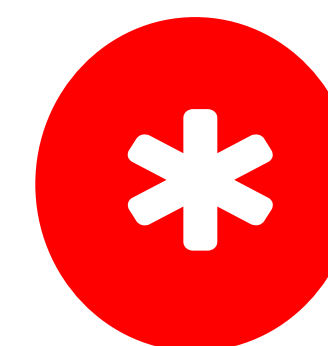
Długie karty graficzne

Zamontuj we wnętrzu karty graficzne o długości nawet 395 mm.



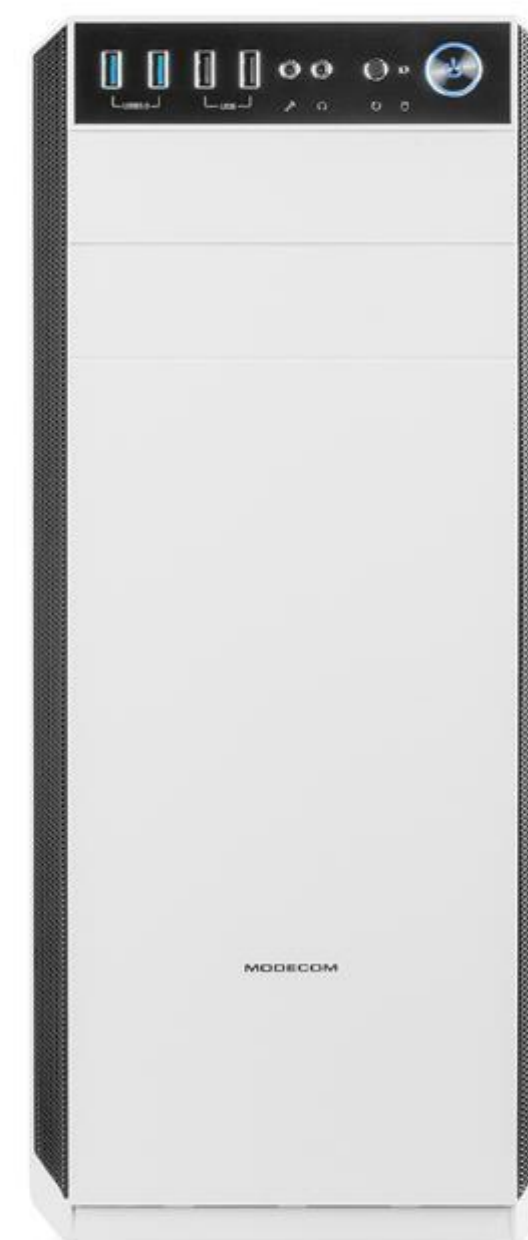
Solidna i trwała konstrukcja

Konstrukcja obudowy wykonana jest z wysokiej jakości pomalowanej na czarno stali SPCC o grubości 0.7 mm.



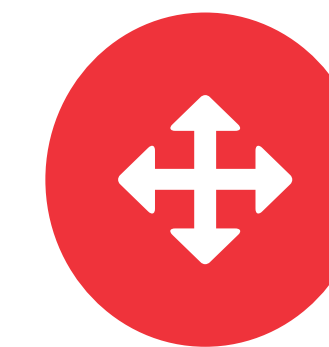
Chłodzenie procesora

Możliwość zamontowania coolera chłodzącego procesor o maksymalnej wysokości 163 mm.



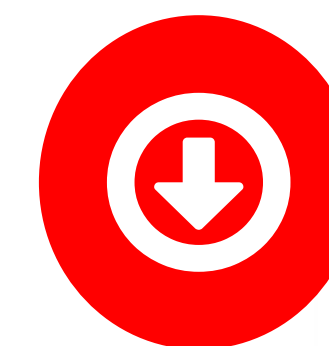
Montaż zasilacza

Dla lepszej wymiany powietrza zasilacz montowany jest na spodzie obudowy w specjalnym tunelu.



Design

Obudowa OBERON PRO to nowoczesna konstrukcja o wyjątkowym, przykuwającym wzrok wzornictwie.



Filtry antykurzowe

Umieszczone bezpośrednio pod zasilaczem, na panelu przednim oraz na górnym panelu filtry zapobiegają przed dostaniem się kurzu do wnętrza obudowy.



Specyfikacja techniczna

MODECOM OBERON PRO

Specyfikacja techniczna

MODECOM OBERON PRO

SPECYFIKACJA	MODECOM OBERON PRO
Rodzaj obudowy	Midi tower
Przeznaczenie	Do domu/ do biura
Wymiary obudowy:	455*205*475 mm (L*W*H)
Format płyty głównej	ATX/ Micro ATX/ ITX
Złącza na panelu przednim/ górnym:	
• USB 3.0	2
• USB 2.0	2
• Wejście na mikrofon	TAK
• Wejście na słuchawki	TAK / HD AUDIO
• Czytnik kart SD/ TF	NIE
Rozwiązania beznarzędziowe	TAK
Miejsca montażowe:	
• zewnętrzne 5,25"	1
• zewnętrzne 3,5"	0
• wewnętrzne HDD 3,5"	2 (możliwość zamontowania w ich miejsce 2 x SSD 2,5")
• wewnętrzne SSD 2,5"	3
Maksymalna liczba wentylatorów	5
Liczba zainstalowanych wentylatorów:	
• przód	1 x 120 mm
• tył	1 x 120 mm
• bok	0
• góra	0
Kontroler obrotów wentylatora(ów)	NIE
Miejsca na karty rozszerzeń	7

Specyfikacja techniczna

MODECOM OBERON PRO

SPECYFIKACJA	MODECOM OBERON PRO
Miejsce montażu zasilacza	dół obudowy
Tunel na zasilacz	TAK – 240 mm
Wysokość chłodzenia procesora	163 mm
Maksymalna długość karty graficznej	395 mm
Informacje dodatkowe:	
• możliwość montażu wodnego systemu chłodzenia	NIE
• panel boczny z oknem	TAK
• filtr pod zasilaczem	TAK
• filtr na panelu górnym	TAK
• filtr na panelu przednim	TAK
• grubość stali	0,7 mm
• waga netto	5,27 kg

OBERON PRO BLACK

Kod: AT-OBERON-PR-10-000000-0002

EAN: 5901885248387

Wymiary opakowania jednostkowego: 520 x 520 x 265 cm

Wymiary opakowania zbiorczego: 520 x 520 x 265 cm

Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

OBERON PRO WHITE

Kod: AT-OBERON-PR-20-000000-0002

EAN: 5901885248394

Wymiary opakowania jednostkowego: 520 x 520 x 265 cm

Wymiary opakowania zbiorczego: 520 x 520 x 265 cm

Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

MODECOM



Dziękujemy

MODECOM Polska

www.modecom.com